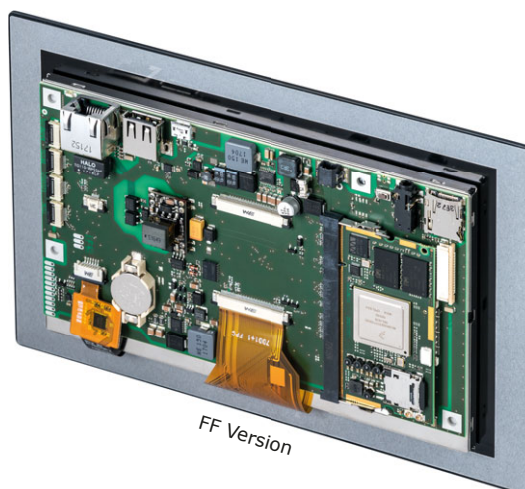


i-PAN T7 CoverLens

Modularer 7.0 Zoll Touchpanel Computer

Keith & Koep

- Ideale Ausgangsbasis für die Integration in kundenspezifische Geräte
- 7.0 Zoll projektiv-kapazitives Touch-Display mit 1,8 mm Glasfront
- Basiert auf Trizeps SODIMM 200 CPU Modul Technologie mit NXP® i.MX 6 Prozessor
- Erweiterungs-Schnittstellen für „Breakout Boards“
- Drahtlose Kommunikation durch Trizeps VII WiFi- und Bluetooth-Komponenten (auf Anfrage)
- POE (Power Over Ethernet) verfügbar
- Die Baugruppen sind einzeln oder als Montageeinheiten erhältlich



Rechnereinheiten basieren auf Trizeps VII SOM und i-PAN T7 Baseboard

Prozessor	NXP i.MX 6 Quad, Dual, DualLite, Solo / 800 MHz – 1 GHz
Arbeitsspeicher	Bis zu 4x 16 Bit DDR3-1066 (533MHz), 16/32/64 Bit 1 CS, 256 MByte to 1 GByte (2, 4 GByte auf Anfrage)
Flashspeicher	Onboard µSD Kartensockel (auf Trizeps VII) mit 4 Bit Busbreite (Standard) für µSD-Karten bis 32 GB oder auf Anfrage Onboard eMMC mit 8 Bit Busbreite (4 bis 32 GB)

Ausstattung

Display	7.0 Zoll TFT-Display 800 x 480 Pixel, 850 cd/qm, projektiv-kapazitives Touch-Display, 1,8 mm Glasfront
Schnittstellen FF Version (Full Function)	USB2.0 Host, µUSB2.0 OTG, RJ45 10/100 Mbit Ethernet, µSD Kartensockel, 3,5 mm Headset-Klinkenbuchse für Mikrofon and Kopfhörer, Realtime Clock mit Backup Batterie, LED, Powerfail-Erkennung
Schnittstellen LC version (Low Cost)	USB2.0 Host, RJ45 10/100 Mbit Ethernet, Realtime Clock mit Backup-Cap, LED, Powerfail-Erkennung
Drahtlose Kommunikation (auf Anfrage)	Trizeps VII Option: Onboard WLAN und Bluetooth Modul, IEEE 802.11 a/b/g/n/e/i/h/d/k/r/w, +18 dBm, 72 Mbps (20 MHz) and up to 150 Mbps (40 MHz), Bluetooth 3.0+ EDR

Erweiterungen für „Breakout-Boards“

Erweiterungs-Schnittstellen FF Version	FFC-Steckverbinder mit USB, I2C, UART, CAN, Keys, Kamera (Raspberry Pi) / Lötkontakte für SPI, Lautsprecher (2,6 W Audio-Verstärker), Kopfhörer, Mikrofon
Erweiterungs-Schnittstellen LC Version	FFC-Steckverbinder mit UART / Lötkontakte für SPI, Kopfhörer, Mikrofon

Allgemeine Angaben

System Software	E-Boot, U-Boot, Barebox, UEFI / Windows Embedded Compact 7, 2013, Windows 10 IoT Core – Linux Kernel 3.035, 4.1.15, 4.4 – Ubuntu 14.04, 16.04, LXDE, Yocto – Android 4.2.2, 6.0
Spannungsversorgung	+12 bis +24V (industrieller Einsatz) / nur für FF Version: POE (Power over Ethernet)
Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C
Abmessungen (B x H x T)	i-PAN T7 Baseboard: 164,0 x 92,0 x 17,0 mm / Display: 201,0 x 133,0 x 8,7 mm
Umweltstandards	RoHS, REACH, WEEE
Verfügbarkeit	10 Jahre Form, Funktion*
Artikel-Nr.	i-PAN T7 CoverLens FF: 47 400.CL / i-PAN T7 CoverLens LC: 47 100.CL (inkl. i-PAN T7 Baseboard FF oder LC, ohne Trizeps VII)



*Beginn Produkt-Lebenszyklus Rev.1804
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.keith-koep.com

Keith & Koep GmbH
Uellendahler Str. 199
42109 Wuppertal
Tel +49-202-25253-0
Fax +49-202-25253-33